

工場建設計画の概要等

1 新設工場の概要

- (1) 名称 株式会社日立ハイテク笠戸製造新棟
- (2) 所在地 下松市大字東豊井字宮ノ洲浜757番1 外
- (3) 事業内容 半導体製造装置の製造
- (4) 操業開始 令和7年4月予定（着工：令和6年2月予定）
- (5) 面積 土地：76,814㎡、工場延床35,116㎡
- (6) 設備投資額 約245億円
- (7) 従業員数 約630人程度（将来的には約860人規模）



計画予定地

「国土地理院の電子地形図 (<https://maps.gsi.go.jp/#13/34.006495/131.895161/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>) を基に企業立地推進課が作成」

2 企業の概要

- (1) 会社名 株式会社日立ハイテク
- (2) 代表者 代表取締役 取締役社長 飯泉 孝
- (3) 本社所在地 東京都港区虎ノ門1丁目17番1号虎ノ門ヒルズビジネスタワー
- (4) 設立 1947年4月12日
- (5) 資本金 約79億円（2022年3月31日現在）
- (6) 売上高 6,742億円（2023年3月期）
- (7) 従業員数 連結13,397名 単独5,288名（2023年3月現在）
- (8) 事業内容
 - ナノテクノロジーソリューション
世界トップシェアの測長SEM、高精度な微細加工を実現したプラズマエッチング装置および欠陥検査装置など
 - アナリティカルソリューション（臨床検査用自動分析装置 等）
 - コアテクノロジーソリューション（電子顕微鏡、光度計 等）
 - バリューチェーンソリューション（光通信関連、鉄道関連検測 等）